



宜特科技股份有限公司

Integrated Service Technology Inc.

故障分析服務委託申請單

TEL : (03) 578-2266

FAX : (03) 563-4868

委工單號：

日期： / /

E-mail : ist@istgroup.tw

委託公司： _____ 電話： _____ 分機： _____ 傳真： _____

委託人姓名： _____ 手機： _____ 電子郵件： _____

Project Code： _____ 產品名稱： _____ 送件數量/委託總數量： _____ / _____

是否有附委託內容說明：否(請以電話聯絡) 是：以 Mail 外勤收件其他： _____ 附上

取件方式：客戶自取 外勤送件 郵寄 其他：

是否需要分析報告及類別：否 是(某些項目報告需收費)：請於備註欄說明報告格式

委 託 項 目

1. 非破壞性分析(請附上檢測位置說明)：X-RAY SAT 超音波顯微鏡分析 OM observation

2. 化性

Decap 後送回 _____ 顆(first bondsecond bond 類比倍率： _____)
特定區域(備註： _____) 133.250.400.650.1150.1530.2300
Decap 後先送回測試，再送做 FIB _____ 顆 Delayer：內容 _____
Decap 後立即做 FIB _____ 顆 去 ACF 膠 _____ 顆
Backside EMMI.OBIRCH 樣品製備 (Die 厚度： _____) 取 Die _____ 顆
拍照：拍照內容：Metal _____ 層polystain 去 Polyimide _____ 顆
是否 X-RAY 標第一 PIN Decap 後做 EMMI _____ 顆
數位倍率： 50.100.200.500.1000.1500 輸出 取 Die 後立即 Assembly _____ 顆

3. FIB 良率預估： _____ 時數預估： _____

工作內容： _____ 製程材質：銅鋁
 製程尺寸： _____ μm
 有無 Polyimide：有 無

4. N-FIB 低電阻 _____ K 電阻 訊號引出 _____ P 電容

5. EMMI 微光顯微鏡分析 E-Beam Testing
OBIRCH 光束誘發阻抗變化 Portable EMMI

6. 材料分析 (實驗項目請附上檢測位置說明)

Dual Beam FIB(定點結構分析) Auger / ESCA
X-section TEM
FESEM SIMS
EDX 其他：請說明於備註欄上

7. ESD & Latch-up (請附“電性測試委工單”) 8. 定量分析(請附電機電子產品委託試驗申請書)

9. Assembly (請附委託內容說明) 10. Reliability Testing (請附委託內容說明)

11. TLP(Transmission Line Pulse) 12. Curve Tracer (Smart-1 / HP4156)

13. Probe Station 租用：Probing 雷射切割 LC 液晶熱點分析 Wafer Level TLP

14. 故障分析 (請附“F/A Service Request Form”)

備註 (記錄與工程師聯絡事項)：

客戶簽名	收件者
-------------	------------

※如有任何疑問，請與相關人員聯絡，或撥客服中心，電話：(03)5782266，分機 8910 ~ 8912